

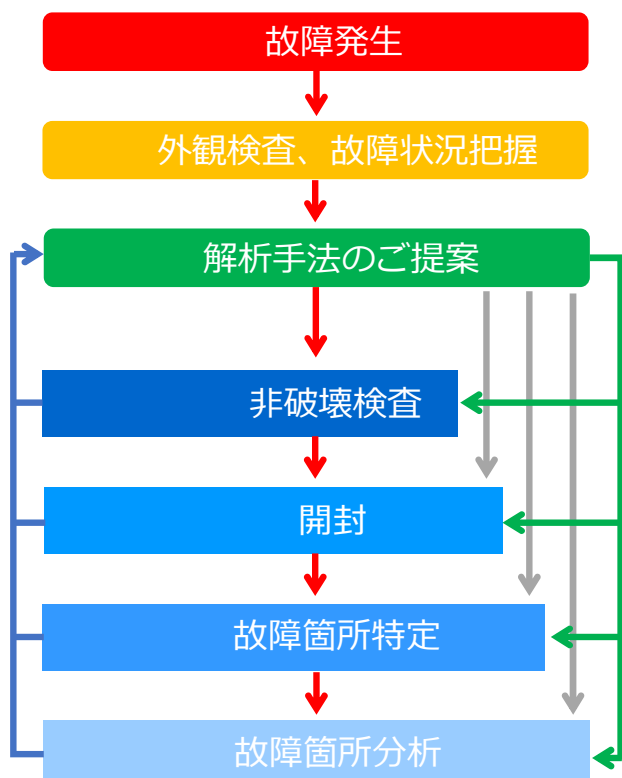
弊社は物理分析に関する主要な分析装置を揃え、様々なご要望にお応え致します。
半導体の分析では微細な形状の観察、結晶性評価、不純物濃度測定、硬度測定、
故障解析などにより研究開発のサポートを致します。

半導体材料分析項目

分析目的	分析項目
原子レベルの構造観察、結晶構造、転位密度、膜厚	HR-TEM
表面形状、断面構造(膜厚)	HR-SEM
結晶性(面方位)、積層膜の周期構造	XRD, XRR
表面組成、結合状態、深さ方向分布	XPS/ESCA
不純物濃度、深さ方向分析	SIMS
結晶構造、応力歪	Raman
構成元素、組成	RBS
表面のヤング率、硬度	Nano Indentation

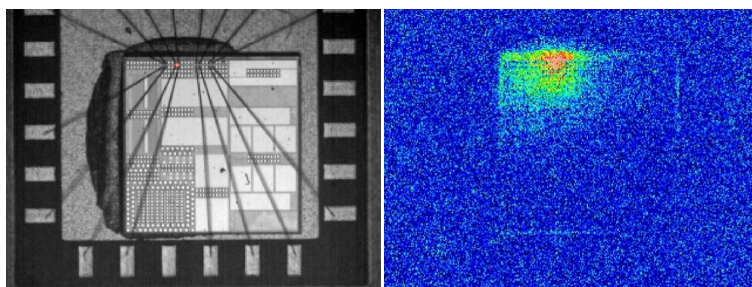
半導体故障解析

故障解析フロー



故障したデバイスの外観検査、非破壊検査、
故障箇所の特定及び詳細な分析を行います

<THEMOS>



<Emission Microscope>

